View in browser

KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI CENTER ZA ČIPE

NOVIČNIK

Petek, 9. oktober 2026

Pozdravljeni,

tudi v tokratnem novičniku smo za vas pripravili izbor nekaterih aktualnih dogodkov in novic s področja čipov in polprevodniških tehnologij.
Med dogodki ne spreglejte webinarja **Your Gateway to European Semiconductor Technologies: CCCs, Pilot Lines & EuroCDP (12. oktober, 2026 ob 13:00h)**, ki predstavlja izbrane možnosti dostopa do ključnih evropskih zmogljivosti, dogodka **Dan najboljše prakse ZEI GZS (20. oktober, 2026)**, namenjenega predstavitvi uspešnih zgodb povezovanja znanja elektroindustrije.

Želimo vam prijetno branje!

Dogodki KC Čip.si:

- Webinar: **Your Gateway to European Semiconductor Technologies: CCCs, Pilot Lines & EuroCDP**
  12. oktober, 2026, 13:00 – 16.00 , on-line



Prijava na dogodek

Drugi dogodki:

- Dogodek **ZEI GZS**: **Dan najboljše prakse – Industrijska povezljivost v praksi: od podatkov do učinkovitih procesov**
  20. oktober, 2026, 9:00 – 14:00 h, podjetje Kontron d.o.o., Kranj
  Dan najboljše prakse v podjetju Kontron bo osvetlil vlogo industrijske povezljivosti pri digitalizaciji proizvodnje. Udeleženci bodo skozi primere iz prakse spoznali koristi naprednih povezovalnih tehnologij, vključno s 5G, ter si ogledali konkretne rešitve za avtomatizacijo, povezljivost in digitalizacijo v demo centru in proizvodnem okolju podjetja.
  Za več informacij je vaš kontakt: Mitja Virant, +386 41 227 240,

mitja.virant@gzs.si
Podroben program, prijavo uredite – tukaj.

- Webinar: **aCCCess Webinar Series on Technology Offers - PIXEurope PL & PIXSpain CCC**
  29. oktober, 10:00 – 11:00 , on-line
  PIXEurope omogoča dostop do celotne verige razvoja fotonskih integriranih vezij (PIC), od izdelave do testiranja, medtem ko PIXSpain kot specializirani kompetenčni center povezuje španski fotonski ekosistem z evropsko PIC infrastrukturo.
  Prijavite se lahko na sledeči povezavi - tukaj.





- Webinar: **Strategy for Start-Ups**
  13. oktober, 2026, 13:30 (CEST), on-line
  Webinar je namenjen ustanoviteljem startupov in drugim, ki podpirajo mlada zagonska podjetja. Profesor Brian Harney (DCU Business School, Dublin City University) bo predstavil, kako oblikovati strateški pristop k rasti že od prvih korakov podjetja ter kako strategijo uporabiti kot načrt za dolgoročni razvoj.
  Prjave na brezplačni dogodek – tukaj.

- Webinar: **2D Pilot Line, advancing 2D-materials integration from lab to fab**
  13. oktober, 15:00, on-line
  Pridružite se spletnemu seminarju o evropski pilotni liniji 2D Pilot Line, namenjeni integraciji grafena in drugih 2D materialov v napredne elektronske in fotonske naprave. Predstavljenie bodo možnosti dostopa do infrastrukture ter priložnosti za usposabljanje in sodelovanje.
  Prijavite se lahko na sledeči povezavi - tukaj.

- Spletno usposabljanje: **INFRACHIP: Healthcare and Edge AI**
  14. oktober, 2026, 11:00, on-line
  Tyndall National Institute v okviru projekta INFRACHIP organizira spletno usposabljanje o polprevodniških tehnologijah za umetno inteligenco na robnih napravah (edge AI) in njihovi uporabi v zdravstvu. Program vključuje prenosne naprave za spremljanje zdravja, energijsko učinkovito nevromorfno strojno opremo, sisteme z izjemno nizko porabo energije ter uporabo AI pri ocenjevanju Parkinsonove bolezni.
  Rok za prijavo: 13. oktober 2026 do 15.00 CEST
  Program in prijava

- Webinar: **Future EU Governance for Technology Infrastructures**
  19. oktober, 11:00 – 12:30 (CEST), on-line
  Na spletnem seminarju bodo predstavljena priporočila EARTO za prihodnje upravljanje tehnoloških infrastruktur v Evropi ter njihova vloga pri krepitvi

razvoja, sodelovanja in dolgoročne vzdržnosti evropskega inovacijskega ekosistema.
Prijavite na spletni dogodek - tukaj.

- Usposabljanje: **Ferrite Circulators: Theory, Design and Simulation**
  26. November, 2026, Beljak, Avstrija
  V okviru pilotne linije FAMES bo potekalo usposabljanje **Ferritni cirkulatorji: teorija, načrtovanje in simulacija**. Udeleženci bodo spoznali teoretične osnove delovanja ferritnih cirkulatorjev, njihove ključne lastnosti za RF-sisteme ter praktične pristope k načrtovanju in validaciji. Delavnica vključuje tudi praktično delo z orodjem ANSYS HFSS, simulacije struktur ter prikaz meritev in primerjavo eksperimentalnih rezultatov s teoretičnimi modeli. Program je namenjen doktorskim študentom, raziskovalcem, inženirjem in predstavnikom industrije.
  Prepogoj za udeležbo je poznavanje RF načrtovanja in simulacijskih orodji.
  Kotizacija: 150 €, popust na skupinske prijave
  Prijavo na usposabljanje opravite na tej povezavi.

- Napoved foruma: **EPoSS Annual Forum 2027**
  8. – 11. junij 2027, Helsinki, Finska
  Dogodek bo združil predstavnike EU, industrije, raziskovalnih organizacij in javnega sektorja ter ponudil tematske seje, predstavitve posterjev, tekmovanje zagonskih podjetij, strokovne obiske in priložnosti za mreženje ter razvoj novih idej.
  Registracijo na dogodek lahko izpolnite tukaj.

Novice:

- **Knjižnica znanj: Nadgradite znanje o polprevodnikih s spletno platformo ECSA**
  European Chips Skills Academy (ECSA) ponuja brezplačna spletna učna gradiva in tečaje za študente, raziskovalce ter zaposlene, ki želijo nadgraditi znanje s področja mikroelektronike. Med razpoložljivimi tečaji so »Intro to Semiconductors«, »Introduction to RISC-V« in »Introduction to Semiconductor Test«. Ponudba vključuje tudi vsebine o močnostnih MOSFET-ih in tehnologiji GaN. Za dostop je potrebna registracija na platformi.

Pregled tečajev in povezave za prijavo

- **Samsung flags 783% profit jump to record $80bn as AI chip boom also lifts TSMC sales**
  Samsung Electronics je v tretjem četrtletju 2026 beležil rekordni dobiček, medtem ko je TSMC dosegel najvišje prihodke doslej. Močno povpraševanje po AI čipih in podatkovnih centrih še naprej spodbuja rast svetovne polprevodniške industrije.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,

vaš KC Čip.si

KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI CENTER ZA ČIPE

Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25,Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran: https://cc-chip.si/

Financira Evropska unija

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljeni na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

Odjava

SENT BY mailerlite